

2025年 法人說明會

總經理 黃道景 2025.12.16

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



公司簡介

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

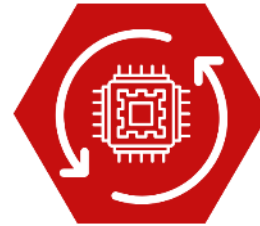


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿



營運報告

(2025 Q3)

綜合損益表

2025年
Q3

(NT\$仟元)	2022	2023	2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	QoQ	YoY
營業收入	1,060,398	976,397	1,153,486	301,151	322,585	306,876	-5%	1%
營業毛利	310,949	255,756	284,926	72,596	70,956	61,847	-13%	-22%
毛利率	29%	26%	25%	24%	22%	20%	-8%	-22%
營業淨利	124,057	75,279	78,293	22,457	27,255	9,599	-65%	-66%
營業外收(支)	110,067	36,565	65,185	19,679	(12,304)	15,454	226%	2255%
稅前淨利	234,124	111,844	143,478	42,136	14,951	25,053	68%	-9%
本期淨利	195,976	93,545	107,452	35,650	18,657	19,346	4%	166%
淨利率	18%	10%	9%	12%	6%	6%		
EPS (NT\$) 註:	4.90	2.12	2.39	0.79	0.41	0.43	5%	169%

註：係追溯調整後

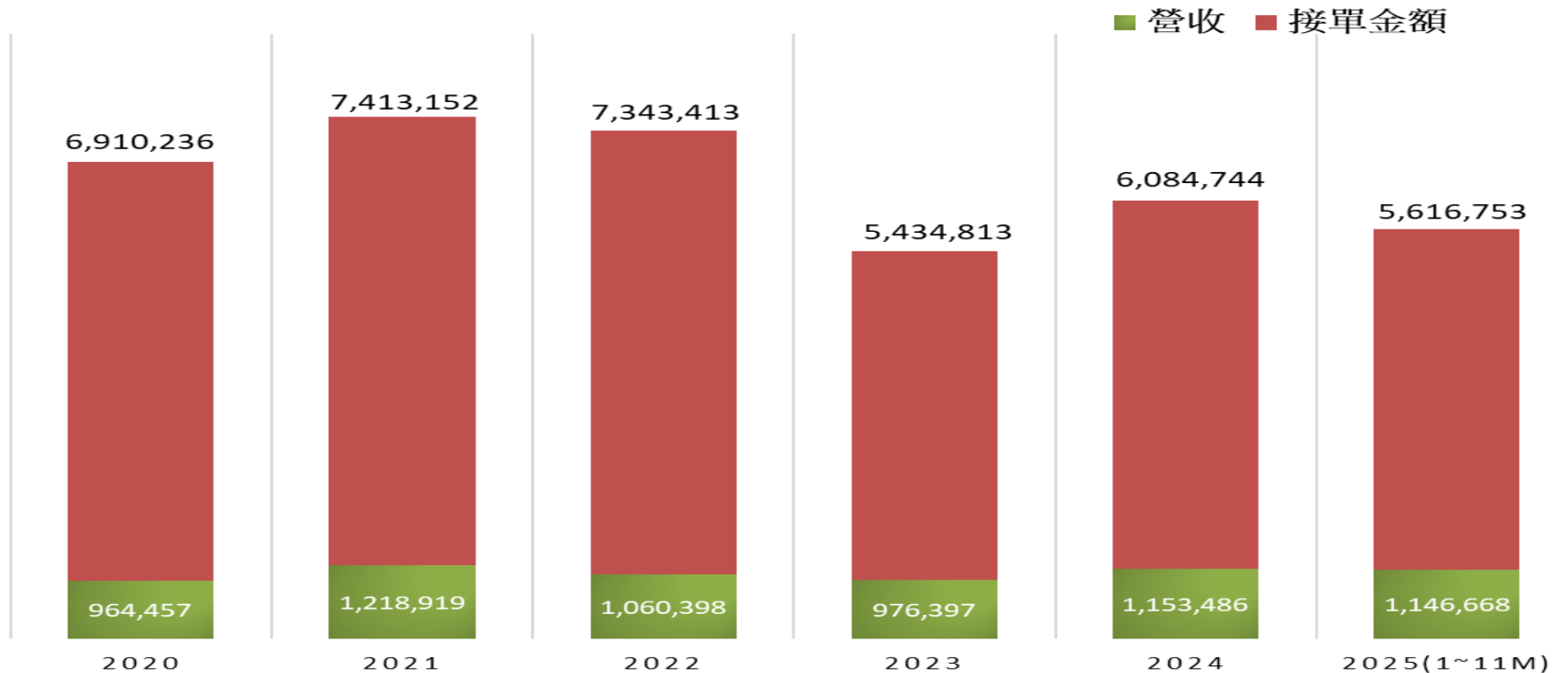
累計前三季每股淨利1.64元

資產負債表

NT\$仟元	2022	2023	2024	Q3 2025
資產				
現金及約當現金	327,431	398,797	333,159	472,295
應收帳款	532,247	443,432	550,367	400,544
存貨	60,048	67,008	60,611	55,832
轉投資相關	257,247	263,434	252,910	111,223
不動產、廠房及設備	226,154	223,341	286,419	287,938
其他資產	26,539	34,288	29,040	54,780
資產總計	1,429,666	1,430,300	1,512,506	1,382,612
負債				
短期借款	150,000	-	-	-
應付帳款	227,968	233,559	315,611	271,630
其他負債	131,435	110,272	122,610	70,990
負債總計	509,403	343,831	438,221	342,620
權益總計	920,263	1,086,469	1,074,285	1,039,992
淨值 (NT\$元 /股)	23.53	24.63	23.87	23.11

歷年營收/接單金額

2025年(1-11月)累計營收已達2024年全年營收99%，2025年全年營收有望創歷史新高。



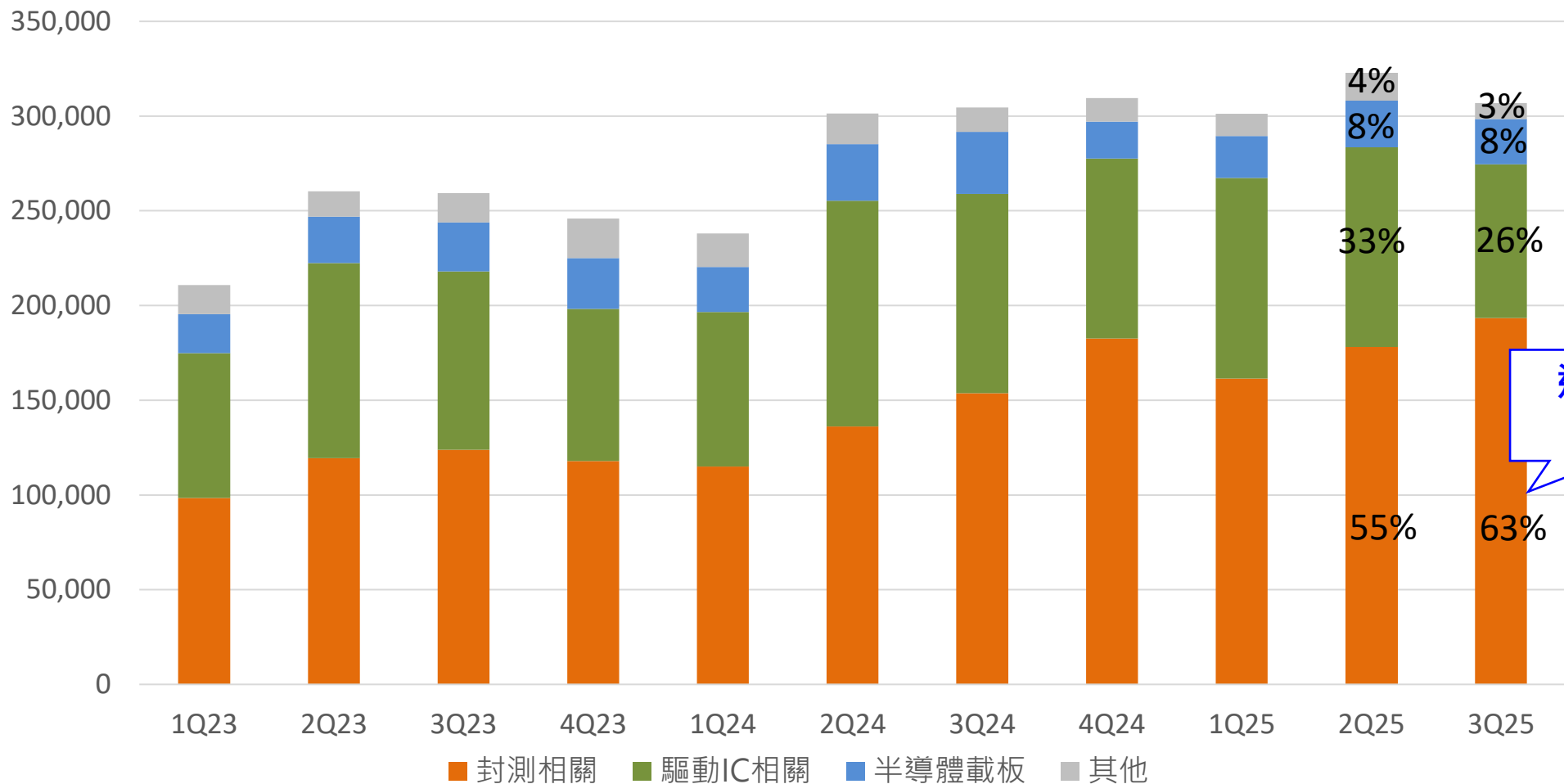
說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

整體季度營收

主要受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）散熱需求持續暢旺

封測相關產品QoQ 9%; YoY 26%。其中均熱片（Heat Spreader）QoQ 80%; YoY 150%，且Q3創歷史新高





營運展望

2026 Strategy

2023

2025

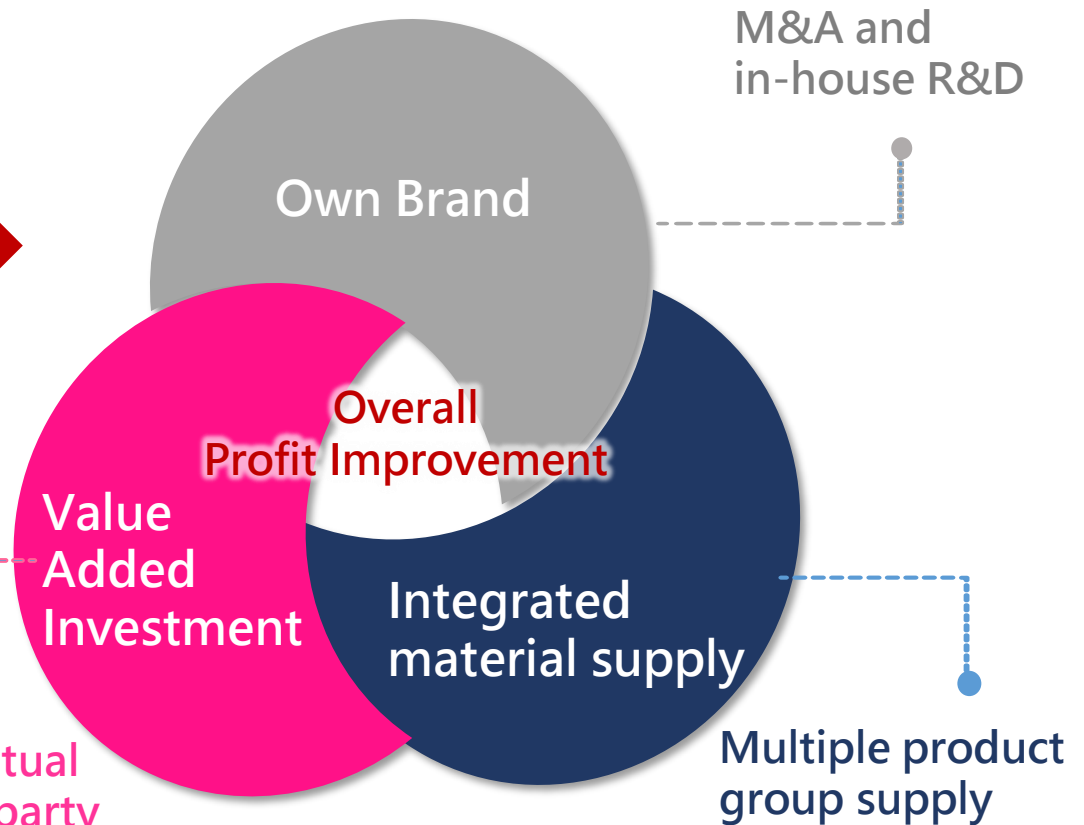
Agent



Integrated Material Solutions Provider



Alliance and mutual benefit to each party



◆ Business Strategies Evolution



2026

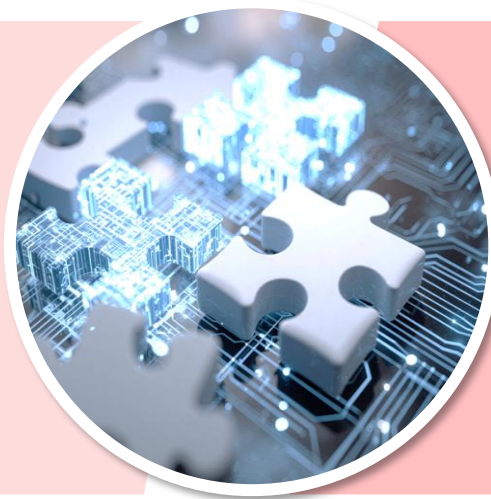


1. Grow Through M&A

Value-chain Integration

Vertical Integration

併購散熱材料廠與電鍍廠



Horizontal Integration

併購其他產品線與代理商

2. Reach New Markets with New Products

Promotion Phase

1. Wafer inspection equipment

1st step – Equipment maintenance

2nd step – Equipment selling

2. Wafer & IC testing – Probe card, BIB

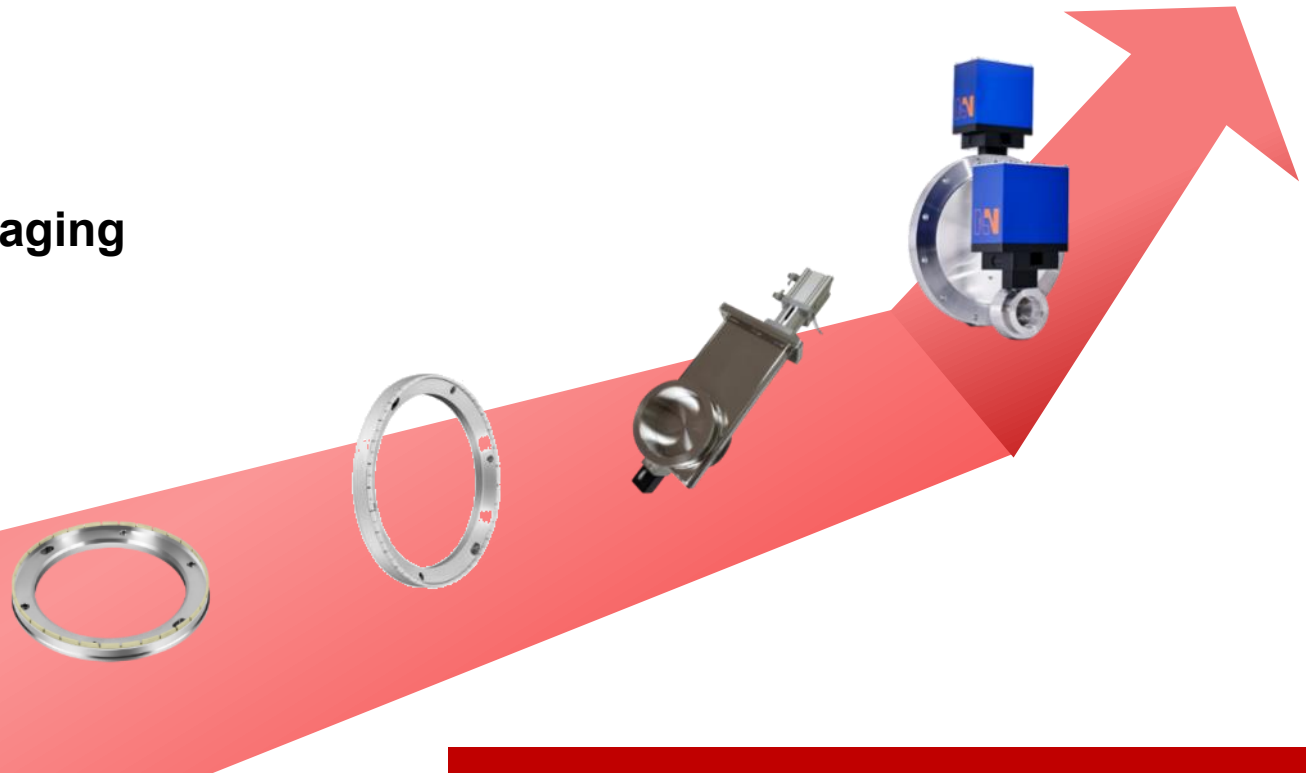
3. Slurry of wafer grinding for advanced packaging

Under Qualification

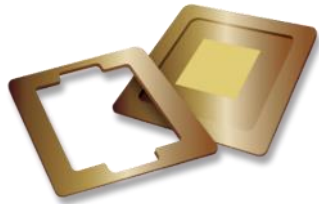
- Dicing blades

Sales Ramp Up

- Vacuum valve



3. Outperform with Thermal Solutions



**Heat
Spreader**



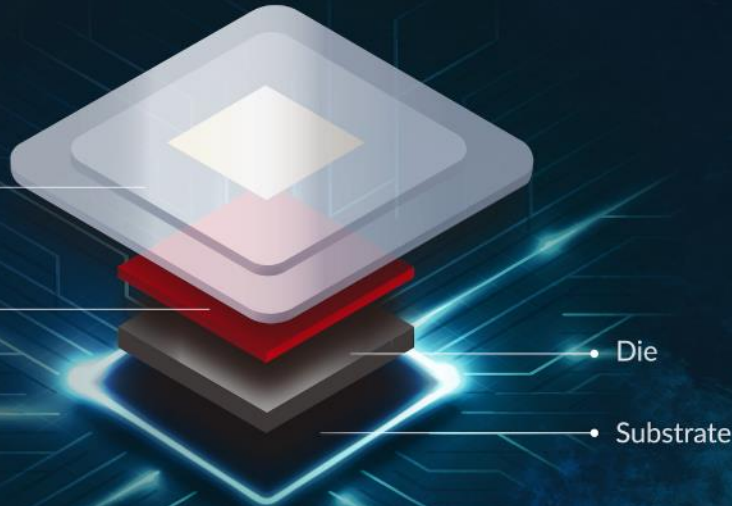
**Ultra High
Thermal Materials**

HEAT SPREADER

Selective Plating
Customization Capability
Consistent Quality

TIM1

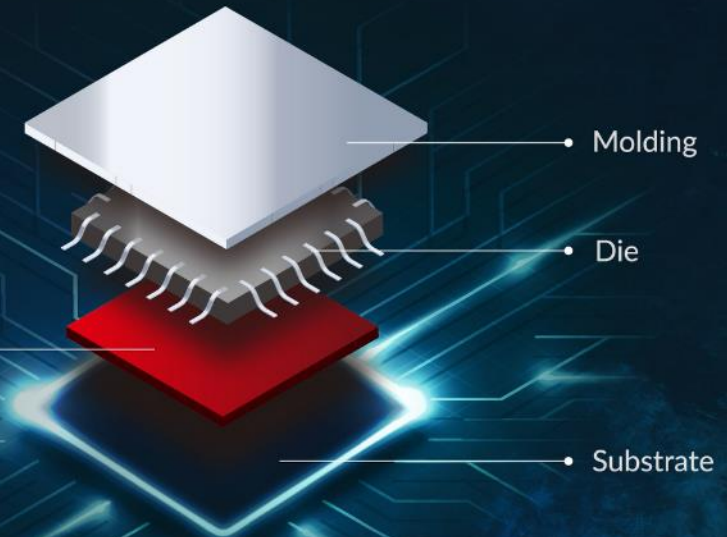
Pressure-less & Printable
Large Size Coverage
Thermal Management



DIE ATTACH

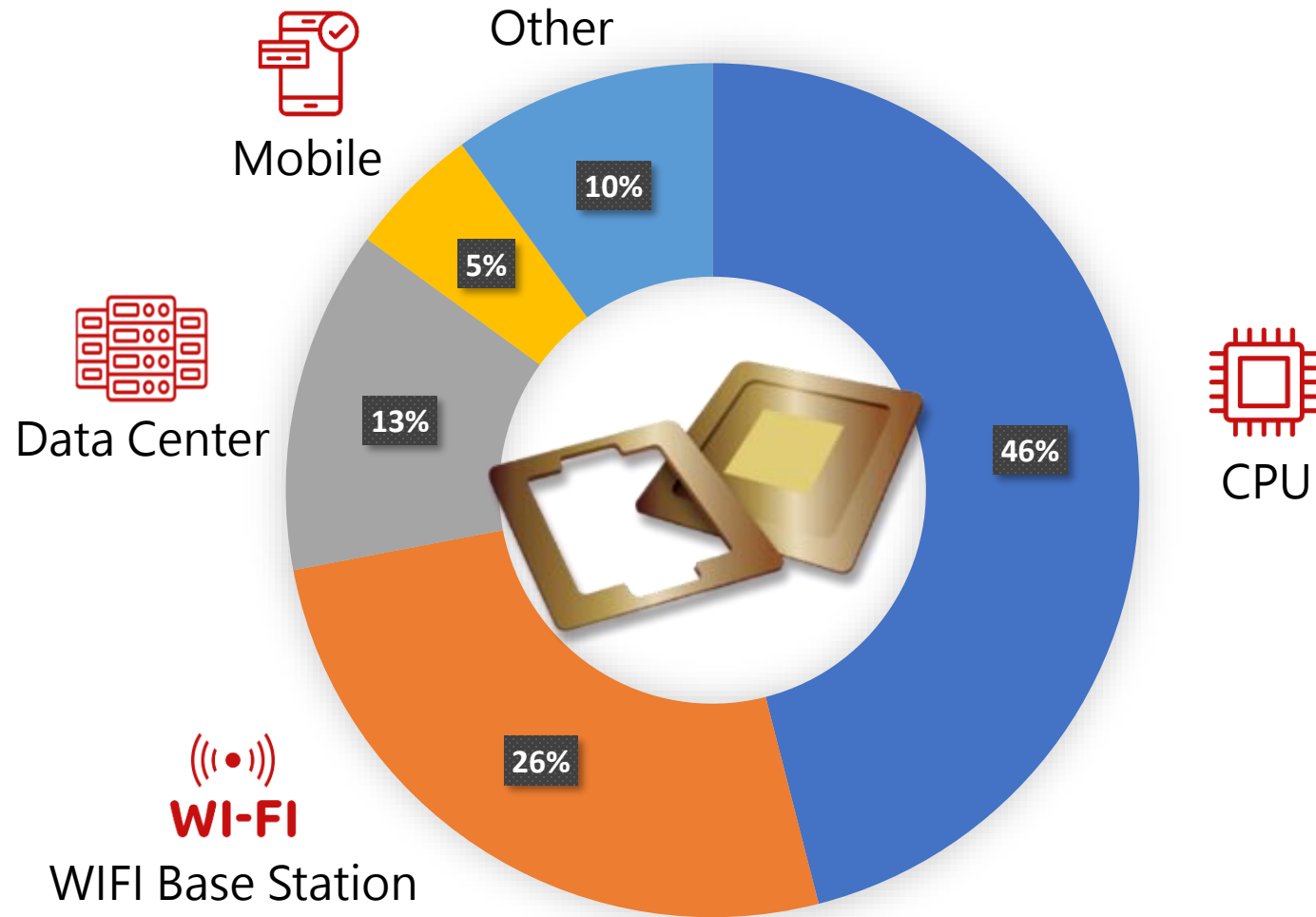
Sintering Silver Paste &
Conductive Silver Paste

Excellent DSS
High Thermal
Low Resistance



3. Outperform with Thermal Solutions

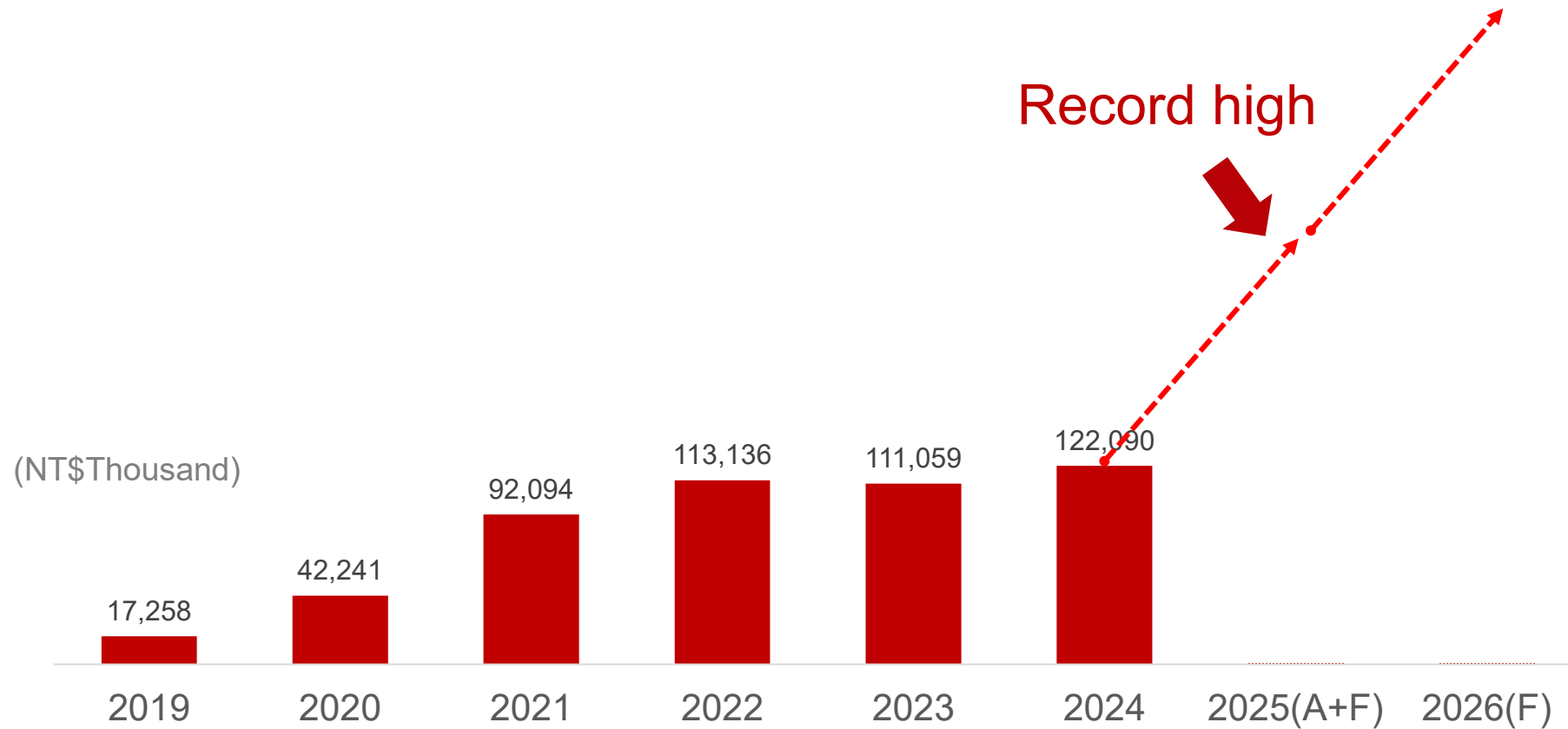
Heat Spreader



3. Outperform with Thermal Solutions

Heat Spreader

Revenue by Year



3. Outperform with Thermal Solutions

Ultra High Thermal Materials

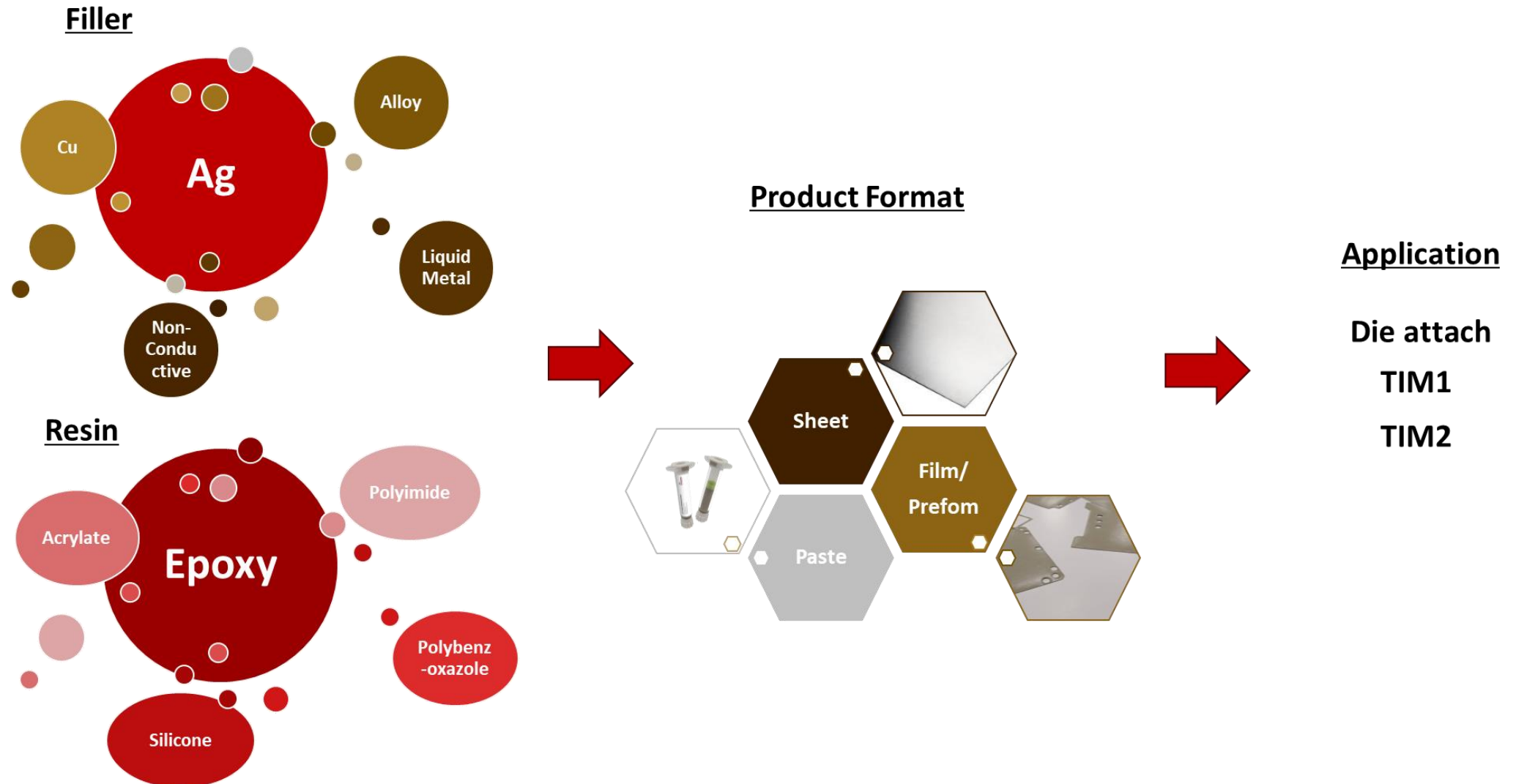


- TIM1

- TIM2

- Die Attach

4. Win with Advanced Materials Technology



- 一. 2025年累計前三季稅後盈餘達7,365萬元，每股淨利1.64元，較去年同期成長3%。
- 二. 2025年第四季全球AI伺服器與記憶體封裝需求進入高峰期，2025年全年營收有望創歷史新高。
- 三. 2026年利機已訂定G.R.O.W.成長策略，聚焦高價值產品組合與新產品導入，結合供應鏈併購案與自有先進材料、散熱管理解決方案，強化獲利體質，追求營收與獲利的穩健成長。

THANK YOU

